

微弧氧化材料表面陶瓷化机理的探讨

邓志威 来永春 薛文彬 陈如意 宋红卫

(北京师范大学低能核物理所, 北京市辐射中心 北京 100875)

摘要 根据大量的实验结果总结了微弧氧化过程中的一些规律。并对铝合金微弧氧化表面陶瓷氧化层形成的机理进行了探讨。

关键词 微弧氧化 表面陶瓷化 耐磨

分类号 TG172.453

1 引言

微弧氧化是一种在高电压、大电流下对金属材料进行表面处理的技术。由于采用了较高的电压(大于250 V), 在微弧氧化处理过程中, 可在样品材料表面观察到光斑(弧光)现象。光斑十分细小, 密度很大, 且无固定位置。这种细小的光斑意味着在样品材料表面形成了大量的等离子体微区。在微区内瞬间温度可达2500℃以上, 压力可达数百个大气压, 为上面提到的一系列化学、物理反应的进行创造了条件。利用这一环境可在材料表面生成具有一定厚度、致密的陶瓷氧化层, 可用来改善材料自身的防腐、耐磨和电绝缘等特性。

微弧氧化是在阳极氧化基础上发展起来的一种材料表面处理方法。但应该指出, 这一技术绝不是阳极氧化的简单改进, 无论是从机理上还是从效果上讲, 两种方法之间都存在着明显的差异。近年来, 各国科学工作者根据自己对微弧氧化的理解和各自的需要, 提出了多种不同的微弧氧化方法^[1~6]。这些方法除具有微弧现象这一共同特征外, 存在着很大的差异, 甚至在命名上都无法统一。这表明, 对可产生微区弧光条件下陶瓷层形成机理还缺乏共识。

2 实验结果与规律的探讨

微弧氧化的过程十分复杂, 给机理研究造成了很大的困难。国际上等离子体微弧氧

化机理研究报道不少, 但多侧重于方法研究和结果的分析。近年来, 低能所对微弧氧化进行了研究和开发, 积累大量的实验数据^[7], 找出了一些基本规律, 并以此为依据对实验方法进行改进, 取得了很好的效果。

2.1 电流随氧化时间变化的规律

本实验以 LY12 铝合金为样品。实验中, 高压是通过脉冲形式施加在样品上。在脉冲高度保持不变的条件下, 观察电流变化规律, 发现了一些有趣的现象。在不同的时间段内, 峰值电流(I_p)变化规律存有差异(见图 1)。由

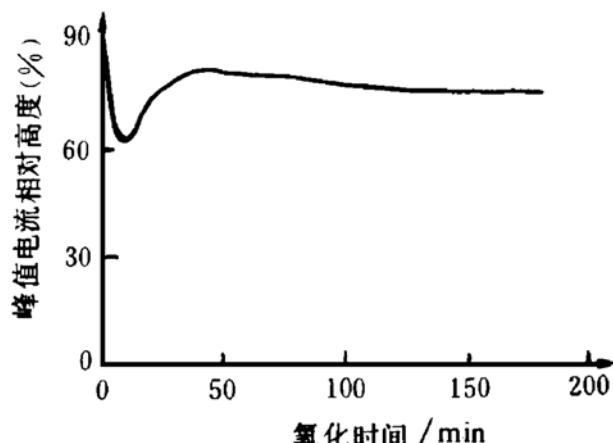


图1 峰值电流 I_p 随时间的变化曲线

图可见, I_p 随(t)的变化明显地分为三个阶段。首先是初始氧化膜形成阶段, I_p 快速下降; 第二阶段为微弧的诱发阶段, I_p 从最小值开始回升; 最后是平衡氧化阶段, I_p 稳定中缓慢下降。第一阶段是否能形成完整的绝缘氧化膜, 是微弧氧化成败的关键, 而诱发阶段微弧的性能(大小和数量)直接影响陶瓷氧化层的

质量。这三个阶段之间存在着明显的转折点。说明在微弧氧化过程中，简单地采用单一的电压不一定合适，应根据氧化过程中的不同阶段，对工作电压进行调整。这样即可以保证初始、诱发弧以及最后生成陶瓷氧化层的质量，同时也可减少能耗。该结论在以后的实验中得到了证实。

2.2 氧化过程中电解液内金属离子浓度的变化规律

LY12铝合金除铝外还含 Si、Cu、Mn、Mg 等元素，这些元素可在微弧氧化过程中进入电解液。用 ICP-AES 分析方法对微弧氧化过程中定时提取的电解液样品进行 Al、Cu、Mn 离子浓度测定，其结果为氧化层形成的机理研究提供了有用的信息。测试结果表明（见图

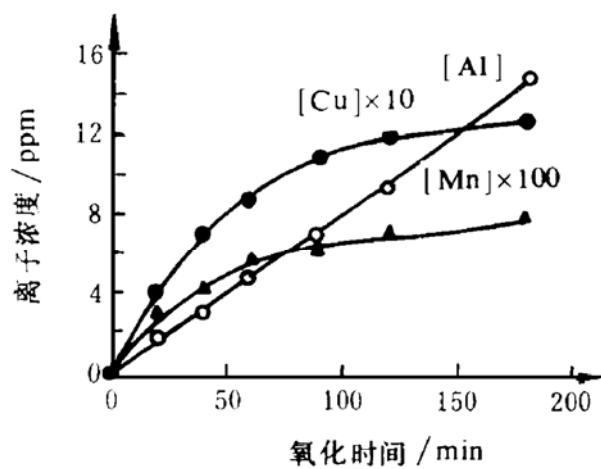


图2 Al、Cu、Mn 离子浓度随时间变化曲线

2)，电解液中 Al、Cu、Mn 离子的浓度均随氧化时间增加而增加，但 Cu、Mn 离子浓度的变化规律却与 Al 不同。根据结果可推导出 Cu、Mn 离子浓度 ($C_{\text{Cu}}, C_{\text{Mn}}$) 近似地与氧化时间 t 的平方根成正比 ($C_{\text{Cu}} = a_{\text{Cu}} t^{1/2}$, $C_{\text{Mn}} = a_{\text{Mn}} t^{1/2}$)；而 Al 浓度 (C_{Al}) 则与时间 t 呈简单的直线关系 ($C_{\text{Al}} = a_{\text{Al}} t$)。其中 a 为常数。电解液中，Al 离子浓度的增加速度基本保持不变；而 Cu、Mn 离子浓度在实验的初始阶段增加很快，随后增加的速度有所下降。

在微弧氧化过程中作为基质的金属铝被氧化生成氧化物，部分氧化物以三氧化二铝的形式滞留在材料表面形成氧化膜，另一部

分以铝酸根的形式进入溶液。在高压电场的作用下，电化学沉积反应又可将部分铝酸根沉积在材料表面。可见电解液中 Al 离子浓度增加的速度受阳极氧化、沉淀溶解平衡和电化学沉积等因素的控制。金属铜、锰等的氧化物易于溶解，因此在实验初始阶段铝合金材料表层的 Cu、Mn 等被氧化后直接进入溶液，所以此时电解液中 Cu、Mn 离子的浓度增加较快。随着时间的增加，氧化向内层发展。此时内层被氧化了的 Cu、Mn 等有一部分通过孔隙扩散还会进入溶液，但由电化学沉积反应而生成的 Al_2O_3 沉积层加厚，还有部分被滞留在新生层内。由此造成电解液中 Cu、Mn 离子浓度增加速度的下降。

分析陶瓷层中 Al、Cu、Mn 含量的测试结果^[8]也可做出相同的解释。微弧氧化生成的陶瓷氧化层具有明显的三层结构，即：外部的疏松层、中间的致密层和内部的结合层。在三种结构中，Cu、Mn 在致密层中含量最高，在疏松层中最低。可以认为疏松层主要由 AlO_2^- 经电化学沉积反应形成的，而电解液中的 Cu、Mn 离子不直接参与该反应，所以疏松层中 Cu、Mn 的含量较低。同时该层的形成阻止了深层氧化后 Cu、Mn 离子进入溶液，加上弧光放电引起的微区高温相变，使 Al、Cu、Mn 等的氧化物形成完整陶瓷层（黑色的致密层），也阻止了 Cu、Mn 向外扩散，所以致密层中 Cu、Mn 含量较高。

2.3 陶瓷氧化层中 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相深度分布规律

利用 X 射线衍射法(XRD)对 LY12 铝合金表面生成陶瓷氧化层(厚度为 $230 \mu\text{m}$)不同深度的相结构进行分析。分析谱图的结果显示， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相构成了陶瓷氧化层的主体。其中 α 相的含量由外向内逐步增加，而 γ 相含量则不断减少(见图3)。在内层具有刚玉结构的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量高达 50% 以上，并与 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 有机结合在一起，因而使氧化层具有很高的硬度。

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为 Al_2O_3 的稳定相，熔点可以达

到2 050℃, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等氧化铝变体则为亚稳相, 在800~1 200℃加热, γ 相可转变为 α 相。微弧氧化可以在材料表面形成大量、微小的等离子体高温区, 这确实为从无序的 Al_2O_3 向 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和从 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变提供了条件。如该过程存在, 由于比重的差异而造成的氧化物体积收缩, 必然要在陶瓷层上有所反应。然而在高倍电子显微镜下观察这种迹象并不存在。所以在微弧氧化过程中, 依次相变不是 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、或 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 形成的主要途径。

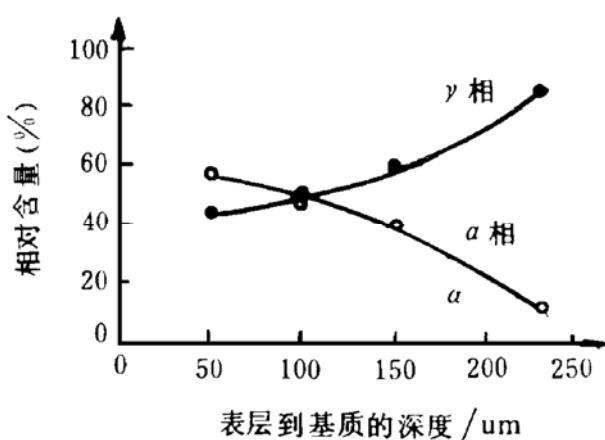


图3 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的分布曲线

McPherson^[9]研究热喷涂 Al_2O_3 亚稳相形成机理时发现, 液滴状熔融的 Al_2O_3 在较大过冷度下 γ 相成核率大于 α 相成核率, 因此高冷却速率导致液滴凝固时易形成 γ 相。利用这一观点可对本实验结果做出更合理的解释。在微弧氧化过程中, 每个火花熄灭瞬间内, 熔融 Al_2O_3 迅速固化形成含有 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结构的陶瓷氧化层。外表层熔融 Al_2O_3 直接同溶液接触冷却速率大, 有利于 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相的形成。由外向内熔融 Al_2O_3 与溶液直接接触的几率减小, 冷却速率逐步下降。所以, 陶瓷氧化层外表面 γ 相的相对含量较高, 并由表向里逐渐下降。 α 相则正好相反, 其相对含量由表向内逐渐升高。这一推理与前面实验结果完全一致。尽管陶瓷氧化膜的形成过程

很复杂, 但最终组成陶瓷膜的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相主要从熔融 Al_2O_3 凝固而来。

3 小 结

微弧氧化的产物是一种多孔状、与基质结合牢固、具有陶瓷特性的氧化物, 其物理、化学特性与微弧氧化处理时电参量的选择、电解液的配方以及样品自身的特性有关, 但与材料基质本身相比, 其耐磨、耐蚀、电绝缘等性能得到明显的改善。与阳极氧化比较, 微弧氧化工艺简单^[7], 对环境污染小, 是一项理想的材料表面改性新技术。

参 考 文 献

- Guenthenschulze A, Bets H. Electronic Conduction in Insulators at Extreme Field Strengths. ibid 1934, 91:196~210
- 邓舜扬. 铝的阳极氧化法的进展. Materials Protection, 1990, 23(9):4~8
- 左洪波, 孔庆山, 尚文琦. 等离子体增强电化学表面陶瓷化技术. 材料保护, 1995, 28(7):21~22
- Van T B, Brown S D, Wirtz G P. Mechanism of Anodic Spark Deposition. American Ceramic Society Bulletin, 1977, 56(6):563~566
- Mahyshev V. Micro-arc Oxidation, A New Method for Strengthening Aluminum Surfaces. Metalloberfakrache, 1995, 49(8):606~608
- Rudnev V S, Gordienko P S. Dependence of the Coating Thickness on the Micro Oxidation (MAO) Potential. Zashch Met, 1993, 29(2):304~307
- 邓志威, 薛文彬, 汪新福等. 铝合金表面微弧氧化技术. 材料保护, 1996, 29(2):15~16
- 来永意, 陈如意, 邓志威等. 微弧氧化技术及其应用. 第一届磨损腐蚀学术会论文集, 柳州, 1996, 196~198
- McPherson R. Formation of Metastable Phases in Flame- and Plasma-prepared Alumina. J Mater Sci, 1973, 8:851~858

(下转第188页)

- 13 Zhang Yinfen, Pan Hongbin, Xie Liqing et al. The DL-alanine ESR Dosimeter in the Radiation Processing. *Radiat Phys Chem*, 1990, 35(4~6): 783~788
- Polymer-Film/ESR Dosimeters in Dosimetry of Ionizing Radiation. *Radiat Phys Chem*, 1993, 42(4~6): 837~840
- 14 Xie Liqing, Zhang Yinfen, Dai Jinxian et al. Uses of

Progress on Radiation Processing by Electron Beam

GU Hongchun GU Yongbao LAN Liqiao LI Fengmei LIU Xiaoguang
QIAN Simin WANG Ying XIE Lichun ZHANG Yinfen

(*Institute of Low Energy Nuclear Physics, Beijing Normal University, Beijing Radiation Center, Beijing 100875*)

Abstract The main recent progress on radiation processing by electron beam-electron irradiation modification on silicon power devices, radiation crosslinking of wires and cables by electron beam and dosimetry for radiation processing are described.

Key Words radiation processing electron beam irradiation modification radiation crosslinking dosimetry

(上接第195页)

Formation Mechanism of Surface Ceramics on Aluminum Alloy with Micro Arc Oxidation

DENG Zhiwei LAI Yongchun XUE Wenbin
CHEN Ruyi SONG Hongwei

(*Institute of Low Energy Nuclear Physics, Beijing Normal University, Beijing Radiation Center, Beijing 100875*)

Abstract With micro-arc oxidation, a ceramic oxidizing layer with the fare thickness and the high density is formed on aluminum alloys. In the work, the formation mechanism of surface ceramics on aluminum alloys with micro-arc oxidation are suggested, based on the experimental data.

Key Words micro-arc oxidation surface ceramics wear-resistance